

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、ヒートシール層と、を少なくとも有し、
 前記ヒートシール層は、測定周波数 1 Hz の動的粘弾性測定において、150℃以下の温度領域での損失正接 $\tan \delta$ が 1 未満である、カバーテープ。
- [請求項2] 前記ヒートシール層が、ポリスチレン系樹脂と、ポリエチレン系樹脂及びアクリル系樹脂からなる群より選択される 1 種以上の樹脂と、を含有する、請求項 1 に記載のカバーテープ。
- [請求項3] 前記ヒートシール層は、測定周波数 1 Hz の動的粘弾性測定において、30℃での貯蔵弾性率 G' (30) と 150℃での貯蔵弾性率 G' (150) との比 $[G' (30) / G' (150)]$ が 800 以下である、請求項 1 又は 2 に記載のカバーテープ。
- [請求項4] 前記ヒートシール層は、測定周波数 1 Hz の動的粘弾性測定において、30℃での貯蔵弾性率 G' (30) が、 1.0×10^6 Pa 以上 1.0×10^8 Pa 未満である、請求項 1～3 のいずれか一項に記載のカバーテープ。
- [請求項5] 収容部を有するキャリアテープと、前記キャリアテープの前記収容部に収容された電子部品と、蓋材として前記キャリアテープにヒートシールされた請求項 1～4 のいずれか一項に記載のカバーテープと、を備える、電子部品包装体。